

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年6月11日(11.06.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/083332 A1

- (51) 国際特許分類:
H01B 1/22 (2006.01) C09D 175/04 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01) H01B 1/00 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/005777
- (22) 国際出願日: 2014年11月18日(18.11.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-251243 2013年12月4日(04.12.2013) JP
- (71) 出願人: 京都エレクトックス株式会社(KYOTO ELEX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6018391 京都府京都市南区吉祥院大河原町一番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 松原 豊治(MATSUBARA, Toyoharu). 留河 悟(TOMEKAWA, Satoru). 新井 貴光(ARAI, Takamitsu). 元久 裕太(MOTOHISA, Yuta).
- (74) 代理人: 特許業務法人 有古特許事務所(PATENT CORPORATE BODY ARCO PATENT OFFICE); 〒6500031 兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階 Hyogo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: HEAT-CURED CONDUCTIVE PASTE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 熱硬化型導電性ペースト組成物

(57) Abstract: Provided is a heat-cured conductive paste composition having superior storage stability by preventing a decrease in conductivity or an increase in viscosity due to storage, even if copper, a copper alloy, a silver-coated copper that is copper coated by silver, or a coated copper alloy that is a copper alloy coated by silver is used as a conductive powder. The heat-cured conductive paste composition contains (A) a conductive powder, (B) a heat-cured resin, (C) a curing agent, and (D) an inorganic ion exchange body, wherein at least one selected from the group consisting of copper, a copper alloy, a silver-coated copper, or a silver-coated copper alloy is used as (A) the conductive powder, and a blocked polyisocyanate compound or a blocked polyisocyanate compound and an epoxy resin are contained as (B) the heat-cured resin.

(57) 要約: 導電性粉末として、銅、銅合金、銅を銀でコートした銀コート銅、または銅合金を銀でコートしたコート銅合金を用いた場合であっても、保存による粘度の増大や導電性の低下を防ぎ、優れた保存安定性を有する熱硬化型導電性ペースト組成物を提供する。(A) 導電性粉末と、(B) 熱硬化型樹脂と、(C) 硬化剤と、(D) 無機イオン交換体とを含有する熱硬化型導電性ペースト組成物であって、(A) 導電性粉末として、銅、銅合金、銀コート銅、および銀コート銅合金からなる群より選択される少なくとも1種を用い、(B) 熱硬化型樹脂として、ブロック化ポリイソシアネート化合物、またはブロック化ポリイソシアネート化合物およびエポキシ樹脂を含有する熱硬化型導電性ペースト組成物を提供する。

WO 2015/083332 A1